

# Лист технической информации

## Укрепление припоя



### Преформы

#### Введение

Получение правильного количества припоя для обеспечения прочного паяного соединения имеет решающее значение в производстве электроники. Однако тенденции миниатюризации, такие как уменьшение толщины трафарета и более плотно подогнанные компоненты, делают это более трудным. Преформы для укрепления припоя **Solder Fortification®** могут обеспечить решение этих сложных проблем. Преформы для укрепления припоя **Solder Fortification®**, как правило, представляют собой прямоугольные или дискообразные кусочки легированного металла, которые не содержат флюса. Преформа добавляется в слой паяльной пасты с использованием стандартного монтажного захватывающего оборудования. Поскольку сплав как для преформы, так и для паяльной пасты одинаков, преформа будет оплавляться при той же температуре, что и паяльная паста, при этом паяльная паста обеспечивает необходимое флюсование. Преформа увеличивает объем припоя по сравнению с тем, чего можно было бы достичь с помощью простой паяльной пасты, особенно для трафаретов с шагом 0,3 мм или менее.

#### Особенности

- Увеличенный объем припоя
- Улучшенные результаты испытаний ударных нагрузок
- Меньше проблем с остатками флюса
- Меньше ремонтных операций
- Улучшенная форма и объем галтели припоя

#### Преимущества

Преимущества преформ для укрепления припоя **Solder Fortification®** включают:

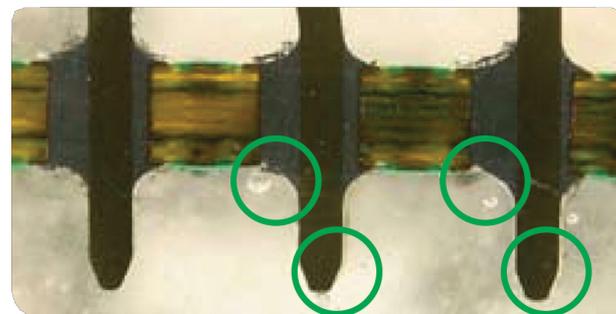
- Увеличенный объем припоя по сравнению с тем, чего можно было бы достичь с помощью простой паяльной пасты
- Меньше проблем с остатками флюса
- Исключение дорогостоящих или трудоемких процессов, таких как пайка волной припоя или селективная пайка
- Более прочные паяные соединения, которые помогают улучшить результаты испытаний ударных нагрузок
- Сокращение ремонта и других ручных процессов для увеличения объема припоя
- Улучшенная форма и объем галтели для обеспечения соответствия соединений спецификациям IPC

#### Упаковка

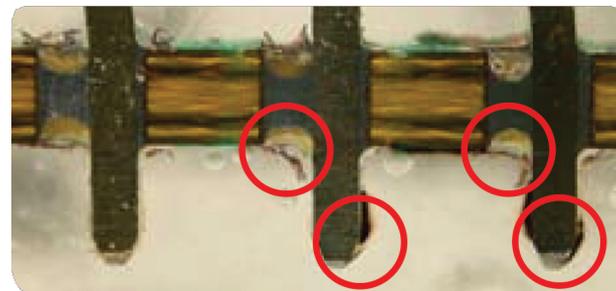
Преформы для укрепления припоя **Solder Fortification®** упакованы в ленту и катушку для удобного размещения монтажными захватывающими установками.

#### Обычные сплавы

- SAC305
- SAC387
- Sn63
- Sn62
- BiSn
- BiSnAg



Преформы припоя + паяльная паста обеспечивают отличные паяные соединения с выводным монтажом



Истощение припоя в паяном соединении, обработанном по технологии PIP. Также обратите внимание на избыточный остаточный флюс.



### ООО «Остек-Интегра»

Оснащение технологическими материалами

121467, Россия, Москва, Партизанская 25, этаж 4, помещение I, комнаты 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 9Б, 9В, 10-20, 33  
+7 (495) 788-44-44 | ostec-materials.ru | materials@ostec-group.ru



## Укрепление припоя

### Наиболее популярные варианты решения для Укрепления припоя Solder Fortification®

Название	Размер	Количество на катушку		Примерный вес SAC305 (грамм/каждый)
		7"	13"	
0201	0,010" x 0,020" x 0,010" прямоугольной формы (0,254 мм x 0,508 мм x 0,254 мм)	1k	50k	0,00024
0402	0,020" x 0,040" x 0,020" прямоугольной формы (0,508 мм x 1,02 мм x 0,508 мм)	1k	15k	0,00182
0603	0,030" x 0,060" x 0,031" прямоугольной формы (0,76 мм x 1,52 мм x 0,787 мм)	1k	15k	0,00672
0805	0,050" x 0,080" x 0,050" прямоугольной формы (1,27 мм x 2,03 мм x 1,27 мм)	1k	15k	0,02410

### Другие распространенные варианты укрепления припоя Solder Fortification®

Название	Размер	Количество на катушку		Примерный вес SAC305 (грамм/каждый)
		7"	13"	
½ 0402	0,020" x 0,040" x 0,010" прямоугольной формы (0,508 мм x 1,02 мм x 0,254 мм)	1k	15k	0,00091
½ 0603	0,030" x 0,060" x 0,015" прямоугольной формы (0,76 мм x 1,52 мм x 0,38 мм)	1k	15k	0,00336
½ 0805	0,050" x 0,080" x 0,025" прямоугольной формы (1,27 мм x 2,03 мм x 0,635 мм)	1k	15k	0,01205



### Техническая поддержка

Инженеры корпорации Indium с международным опытом оказывают нашим клиентам всестороннюю техническую помощь. Компетентные во всех аспектах материаловедения применительно к секторам электроники и полупроводников инженеры технической поддержки предоставляют экспертные консультации по свойствам припоя, совместимости сплавов и выбору преформ припоя, проволоке, ленте и пасте. Инженеры технической поддержки корпорации Indium обеспечивают быстрое реагирование на все технические запросы.

### Паспорта безопасности

Паспорт безопасности для данного продукта можно найти в Интернете по адресу <http://www.indium.com/sds>

